

<<混合微电路技术手册>>

图书基本信息

书名：<<混合微电路技术手册>>

13位ISBN编号：9787505395398

10位ISBN编号：7505395394

出版时间：2004-4

出版时间：电子工业

作者：(美)James J.Licari Leonard R.Enlow

页数：380

字数：537300

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<混合微电路技术手册>>

内容概要

本书是一本介绍厚薄膜混合微电路的书籍。

重点叙述了生产高可靠混合电路产品所用的材料、制造工艺、组装工艺、测试和设计技术、技术文件、失效分析及多芯片模块技术。

本书内容新颖详实，是美国混合微电路专家的经验之谈。

很适合我国从事混合微电路专业的经理、工程技术人员阅读，也适合于从事整机电子线路的工程技术人员参考，以便将混合微电路恰到好处地融合进整机设计，本书也非常适合作为微电子和电子工程专业的高年级大学生和研究生的教学参考书。

<<混合微电路技术手册>>

作者简介

James J.Licari 现任美国加利福尼亚州维梯耶市的Avan Teco公司总裁，是微电子材料和工艺的咨询专家。
此前，他曾任位于加利福尼亚州新港海滩市的休斯公司微电子分部的首度科学家，体育场开发了高可靠军事和航天应用的高密度、高性能的多芯片模块。
Licari博士毕业于普林斯

<<混合微电路技术手册>>

书籍目录

第1章 引言 1.1 微电子材料分类 1.2 工艺分类 1.3 混合电路的定义和特性 1.4 应用 参考文献第2章 基片 2.1 功能 2.2 表面特性 2.3 氧化铝基片 2.4 氧化铍基片 2.5 氮化铝基片 2.6 金属矩阵复合物 2.7 陶瓷基片的制造 2.8 上釉的金属基片 2.9 质量保证和测试方法 参考文献第3章 薄膜工艺 3.1 淀积工艺 3.2 薄膜电阻器工艺 3.3 光刻材料和工艺 3.4 腐蚀材料和工艺 3.5 薄膜微桥跨接电路 参考文献第4章 厚膜工艺 4.1 制造工艺 4.2 直接描入 4.3 各种浆料 4.4 非贵金属厚膜 4.5 聚合物厚膜 参考文献第5章 电阻器的调整 5.1 激光调阻 5.2 喷砂调阻 5.3 电阻器的探针测量技术 5.4 电阻微调的类型 5.5 特殊要求 参考文献第6章 部件选择 6.1 一般性考虑 6.2 封装 6.3 有源器件 6.4 无源元件 参考文献第7章 组装工艺 7.1 引言 7.2 芯片和基片的贴装 7.3 互连 7.4 清洗 7.5 使颗粒不能移动的涂覆 7.6 真空焙烤和密封 参考文献第8章 试验第9章 操作和净化间第10章 设计指南第11章 文件和技术规范第12章 失效分析第13章 多芯片模块：混合微电路的新品种

<<混合微电路技术手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>